

Jetzt online anmelden unter
www.leistungshalbleiter-anwenderforum.de

19. - 20. NOVEMBER 2019
 HYPERION HOTEL MÜNCHEN

Leistungshalbleiter
ANWENDERFORUM

DIENSTAG, 19. NOVEMBER 2019

09:00 - 09:30	Keynote: The Power of Integration	<i>Balu Balakrishnan</i> , Power Integrations
09:30 - 10:15	Intensivseminar: Aktuelle und zukünftige Ladegeräte-Topologien für Industrie und Elektromobilität	<i>Tobias Fuhr</i> , Finepower
KAFFEEPAUSE UND NETWORKING IN DER AUSSTELLUNG		
11:00 - 11:30	Analysis of PCB parasitic effects in a Vienna Rectifier for an EV battery charger by means of Electromagnetic Simulations	<i>Simon Muff</i> , Keysight
11:30 - 12:00	All Roads Lead to Rome: SiC, GaN and Si Technologies in Switch Mode Power Supplies	<i>Francesco Di Domenico</i> , Infineon Technologies
12:00 - 12:30	Technologies and Benefits of the DIPIPM Family	<i>Muzaffer Albayrak, Philipp Jabs</i> ; Mitsubishi Electric
MITTAGSPAUSE UND NETWORKING IN DER AUSSTELLUNG		
13:45 - 14:15	Keynote: SiC: From Niche to Mass Production	<i>Christian André</i> , ROHM Semiconductor
14:15 - 14:45	Strukturelle Integrität von Leiterplatten und Verbindungstechniken in der Leistungselektronik	<i>Holger Krumme</i> , HTV
14:45 - 15:15	Enrich the Connection to SiC	<i>Simon Kleefeldt</i> , Mekttec Europe
KAFFEEPAUSE UND NETWORKING IN DER AUSSTELLUNG		
16:00 - 16:30	Boosting Performance of a New Generation of Power Converters with integrated GaN solutions G-FET™ & G-Drive™	<i>Eric Moreau</i> , Exagan
16:30 - 17:00	Chip-Temperatur – Licht ins Dunkel bringen	<i>Dr. Martin Schulz</i> , Infineon Technologies
17:00 - 17:30	Barrier Insulation Evaluation and Research (BIER)	<i>Markus Stöger</i> , RECOM Engineering
17:30 - 18:00	Höherer Wirkungsgrad und Leistungsdichte mit Advanced Synchronous Reverse Blocking (A-SRB)	<i>Dr. Mario Ackers</i> , Toshiba Electronics
Ab 18:00 Uhr	GET-TOGETHER UND NETWORKING IN DER AUSSTELLUNG	

MITTWOCH, 20. NOVEMBER 2019

09:00 - 09:30	Keynote: SiC Performance at the Price of Silicon	<i>Bruce T. Renouard</i> , Pre-Switch
09:30 - 10:30	Intensivseminar: Bestimmung und Auswirkung parasitärer Effekte von Wechselrichter-Aufbauten	<i>Dr. Christian Römelsberger</i> , CADFEM
KAFFEEPAUSE UND NETWORKING IN DER AUSSTELLUNG		
11:15 - 11:45	Einführung in den Schutz von SiC-MOSFETs	<i>Olaf Bendix</i> , Infineon Technologies
11:45 - 12:15	3,6-kW-Totem-Pole-PFC mit SiC-MOSFETs zur Anwendung in Automotive On-Board-Chargern	<i>Dr. Christian Felgemacher</i> , ROHM Semiconductor
MITTAGSPAUSE UND NETWORKING IN DER AUSSTELLUNG		
13:30 - 14:00	Keynote: Challenges in power electronics packaging and ways to tackle them	<i>Peter Sontheimer</i> , SEMIKRON
14:00 - 14:30	Enabling the EV Revolution through SiC Power Semiconductors	<i>Avinash Kashyap</i> , Microchip Technology
14:30 - 15:15	1200 V - 20 mOhm SiC MOSFET, Zuverlässigkeit und Performance für den Massenmarkt	<i>Mehrdad Baghaie</i> , ON Semiconductor
KAFFEEPAUSE UND NETWORKING IN DER AUSSTELLUNG		
15:45 - 16:15	Application of GaN Devices with GaNdalf	<i>Edwin Kluter</i> , Future Electronics
16:15 - 17:00	Verifiziertes dynamisches Simulationsmodell für GaN-HEMT-Bauelemente	<i>Achim Endruschat, Holger Gerstner</i> , Fraunhofer IISB

Gold Sponsoren



Silber Sponsoren



Bronze Sponsoren



Sponsor



Powered by



www.leistungshalbleiter-anwenderforum.de

Änderungen vorbehalten



Leistungshalbleiter

ANWENDERFORUM

**19. - 20. NOVEMBER 2019
HYPERION HOTEL MÜNCHEN**

Diese Konferenz soll die wichtigsten Grundlagen und Anwendungshinweise zu MOSFET & Co. vermitteln. Reicht noch ein Superjunction-MOSFET für die angestrebte Applikation, oder wäre der Übergang auf GaN-Transistoren sinnvoll? Würde der ausgewählte Treiber-IC auch mit anderen Leistungshalbleiter-Technologien funktionieren? Mit welchen Varianzen ist bezüglich den Angaben im Datenblatt zu rechnen? Welche Aspekte sind für eine qualifizierte Vorauswahl entscheidend, und welche weitergehenden Fragen an die Hersteller, erleichtern Entscheidungsfindung und Sourcing? Hilfestellung sollen Entwickler auf dem »Anwenderforum Leistungshalbleiter« erhalten, das die **Markt&Technik** sowie **DESIGN&ELEKTRONIK** vom **19. bis 20. November 2019 bereits zum dritten Mal** in München veranstalten.

Anmeldecoupon

ausfüllen, abschicken, teilnehmen

Alle mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung per Email.

Hiermit melde ich mich verbindlich an:

Dienstag, 19. November 2019

Mittwoch, 20. November 2019

Name * Anrede*

Vorname*

Jobtitel Abteilung

Firma

Straße*

PLZ/Ort* Land

Telefon*

Email*

Bestellnummer / UStId-Nr. o.ä.

Datum/Unterschrift*

Sie möchten eine alternative Rechnungsadresse angeben? Bei der Online-Anmeldung auf www.leistungshalbleiter-anwenderforum.de/ **anmeldung** können Sie diese ganz einfach mit ausfüllen.



Veranstaltungsort:
HYPERION Hotel München
Truderinger Strasse 13
81677 München

Teilnahmegebühren	Frühbucher bis 16.09.2019	Ab 17.09.2019
1. Tag - 19.11.2019	390 €	460 €
2. Tag - 20.11.2019	390 €	460 €
Beide Tage	550 €	655 €

Alle Preise zzgl. MwSt.: 19%

Kontakt

Sie haben Fragen? Ich helfe Ihnen gerne weiter.



Nina Thonesen
Tel.: +49 (0) 89 / 255 56-1323
Email: NThonesen@weka-fachmedien.de
www.leistungshalbleiter-anwenderforum.de

Teilnahmebedingungen:

- Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.leistungshalbleiter-anwenderforum.de.
- Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. (19%).
 - In diesem Betrag enthalten sind Tagungsunterlagen sowie Mittagsbüffet und Pausengetränke.
 - Studenten gewähren wir 50% Rabatt, bitte Immatrikulationsbescheinigung hochladen oder per Email senden (NThonesen@weka-fachmedien.de).
 - Die Rechnungsstellung erfolgt mit der Anmeldebestätigung zeitnah zur Anmeldung.
 - Bei Stornierung der Anmeldung bis zum 16. September 2019 erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 50,- EUR bei eintägiger bzw. 100,- EUR bei zweitägiger Teilnahme (zzgl. gesetzl. MwSt.), bei Absage ab dem 17. September 2019 oder Nichterscheinen wird die gesamte Tagungsgebühr fällig.
 - Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist möglich.
 - Bei Anmeldung von mind. 5 Personen einer Firma bieten wir Sondertarife an. Für weitere Details nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf: NThonesen@weka-fachmedien.de

**Senden Sie den ausgefüllten Coupon via Email an
NThonesen@weka-fachmedien.de oder buchen Sie direkt unter
www.leistungshalbleiter-anwenderforum.de.**